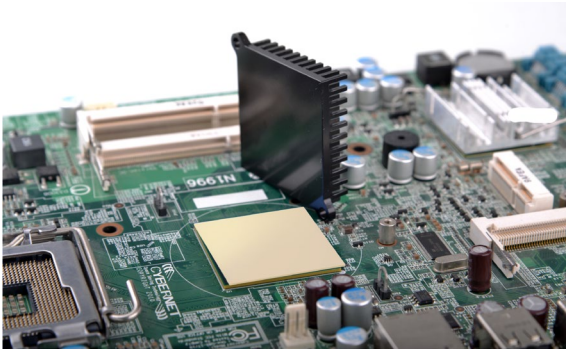


低挥发导热硅胶片

TP200-H25-L是一款低挥发导热垫片，使用硅胶与导热陶瓷填料经由特殊工艺加工而成，双面自粘，低压缩力下表现出良好的导热性能和电气绝缘性能，在-40℃~150℃可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。



特性和优点

- 导热系数2.0W/(m·K)
- 低压缩力应用
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 低挥发
- 容易装配可重复使用

典型应用

- LCD背光模块
- 网络通讯设备
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元
- 冷却器件到底盘或框架之间
- 平面显示器

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	浅黄色	目视
厚度(mm)	1.0~10.0	ASTM D374
密度(g/cc)	2.82	ASTM D792
硬度(Shore 00)	25	ASTM D2240
挥发冷凝物含量	无挥发冷凝物	玻璃瓶烘烤150℃/168h 目测
重量损失(% @150℃)	<0.1	ASTM E595-07
低分子硅氧烷含量D3~D20(ppm)	≤50	US EPA3550C:2007 & US EPA 8270E:2018,检测精度5ppm
耐温范围(℃)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度<40℃避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥6.0	ASTM D149
介电常数(@1MHz)	5.72	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹³	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	2.0	ISO 22007-2
热阻(℃·in ² /W @20psi,1.0mm)	0.2	ASTM D5470